

Datenblatt Herstellung Leiterplatten, Dünnschicht

Basismaterialien	Standard FR4	
	Anzahl Lagen (typisch)	bis 10
	(höhere Lagenanzahl möglich)	
	min. End-Kupfer-Dicke	35 µm
	max. End-Kupfer-Dicke	105 µm
	T _g	130/150/170 °C
Layout	Strukturbreite	125 µm
	Strukturabstand	125 µm
	uml. Löstopplack-Freistellung	50 µm
	kleinster Löstopplack-Steg	150 µm
	kleinste Restringe	125 µm
	kleinste Bohrung (Via)	0,2 µm
	kleinster Fräsradius	250 µm
	kleinster Ritzwinkel	30 °
	Durchkontaktierung	> 20 µm
	Kantenmetallisierung	möglich
Oberfläche	HAL bleifrei	
	HAL SnPb	
	chem. Zinn	
	chem. Ni/Au	
	chem. Ag	
	Hartgold, Bondgold	
	Carbondruck	
Löstopplack	grün / schwarz / blau / rot ...	
	superweiß (für LED- Anwendungen)	
	Durchsteigerfüller	
	abziehbare Lötdeckmaske	
	Kaptonband, hitzebeständig bis 260°C	
Kennzeichendruck	weiß / gelb / schwarz ...	
Qualitätskontrolle	optische Kontrolle	
	AOI	
	elektrischer Test	
	Erstmusterprüfung	
Daten	vorzugsweise Gerberdaten	
	Eagle	
	TARGET, PROTEL, Altium, etc.	
Zertifikate / Normen	ISO 9001:2015	
	IPC-A-600	
andere Materialien und Ausführungen auf Anfrage		